

Bond E1

Datasheet

Bond E1 是一种热塑性改性环氧粘合层。在线圈卷绕期间或之后，经加热会软化和回流。

粘合说明

Bond E1 通常被用于制作粘合性磁线的聚氨酯或聚酯或聚酰亚胺绝缘底层的覆盖涂层。当热丝软化邻匝上的涂层且粘合层流动到一起时，此类线材将实现自身粘合。在冷却后，表面涂层会变硬，从而将匝固定到位。涂有 Bond E1 的线材的粘合应被视为可逆的，因为恢复到高温将再一次软化涂层。

Bond E1 在 120°C 和 140°C (248-284°F) 之间软化。在 130°C 下 10 分钟可达到完全粘合强度。延长时间或升高温度可增加导体之间的有效粘合区域，从而适度提高性能。当然，应该进行服务测试以验证绕线结构、粘合过程和释气性能的充分性。

上述后烘烤周期是指处于该温度下的时间。强制热空气站的烤炉可能需要额外的时间或更高的温度才能将线材提升到所需的粘合温度。

通过应用电流来加热线圈的电阻是一种有效的粘合方法。线材在高达 220°C (428°F) 的温度下最多可以承受几分钟。同样，优化粘合过程取决于用户本身。

粘合性线材的限制

请注意，粘合性磁线在绕组的缝隙中效率低下，只有在相邻导体密切接触时，它才能很好地粘合。0.073-0.38 毫米(0.003-0.015 英寸)细线和精密线圈，使您能够获得粘合性线材技术的益处。

Disclaimer: Recommendations are for guidance only, and the suitability of a material for a specific application can be confirmed only when we know the actual service conditions. Continuous development may necessitate changes in technical data

without notice. This datasheet is only valid for Alleima materials.